

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年7月10日(2014.7.10)

【公表番号】特表2013-535807(P2013-535807A)

【公表日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【年通号数】公開・登録公報2013-050

【出願番号】特願2013-517288(P2013-517288)

【国際特許分類】

H 01 L 23/50 (2006.01)

H 05 K 1/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/50 B

H 01 L 23/50 N

H 05 K 1/18 H

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年5月26日(2014.5.26)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路基板とはんだ付け接続されるSMD部品に用いられる接続部材であり、
金属材料と、

回路基板とのはんだ付け接続に用いられる実質的に積層状の接続エリアと、
導電領域と

を備え、

前記金属材料は、他の金属材料によって一方の面のみがコーティングされ、鋼の片、線
、又はシートから金属片を打ち抜くことによって提供され、

前記積層状の接続エリアは、縁領域を有し、

はんだ付けによって回路基板と接続された状態ではんだフィレットが形成され、前記縁
領域が前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し実質的に平行に配置されるよう、
前記縁領域の少なくとも1つの部分が前記積層状の接続エリアから突出し、

前記縁領域と前記積層状の接続エリアは、前記一方の面のみが前記コーティングされた
鋼の片、線、又はシートから形成され、

前記はんだフィレットは、前記縁領域における、前記回路基板と前記コーティングの間
に形成される、

接続部材。

【請求項2】

前記縁領域が、前記積層状の接続エリアの上方に、前記金属材料の厚さの20倍以下の
距離だけ突出する、請求項1に記載の接続部材。

【請求項3】

前記縁領域が、前記積層状の接続エリアの上方に、前記金属材料の厚さの2倍以下の距離
だけ突出する、請求項1または2に記載の接続部材。

【請求項4】

前記縁領域の部分が、前記積層状の接続エリアに対し、およそ45°からおよそ90°
傾いている、請求項1から3のいずれか1項に記載の接続部材。

【請求項 5】

前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し略垂直に配置される縁領域をさらに備える、請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の接続部材。

【請求項 6】

回路基板とはんだ付け接続される SMD 部品に用いられる接続部材を製造する方法であり、

一方の面のみがコーティングされた鋼の片、線、又はシートを提供する段階と、

前記鋼の片、線、又はシートから金属片を打ち抜く段階と、

前記金属片を曲げ、導電領域および積層状の接続エリアを形成する段階と、

前記積層状の接続エリア上に縁領域を形成する段階と

を備え、

はんだ付けによって前記回路基板と接続された状態ではんだフィレットが形成され、前記縁領域が前記積層状の接続エリア上の前記導電領域に対し実質的に平行に配置されるよう、前記縁領域の少なくとも 1 つの部分が前記積層状の接続エリアから突出するよう形成され、

前記縁領域と前記積層状の接続エリアは、一方の面のみが前記コーティングされた前記鋼の片、線、又はシートから形成され、

前記はんだフィレットは、前記縁領域における、前記回路基板と前記コーティングの間に形成される、

方法。

【請求項 7】

前記縁領域を形成する段階は、曲げる段階を有する、請求項 6 に記載の方法。

【請求項 8】

前記形成する段階および前記曲げる段階は、1 つの段階である、請求項 6 または 7 に記載の方法。

【請求項 9】

前記形成する段階、前記曲げる段階および前記打ち抜く段階は、1 つの段階である、請求項 6 から 8 のいずれか 1 項に記載の方法。